

壹、計畫內容：

▶ 子計畫 1-4-A：半導體產業產學發展計畫

近年來最熱門的物聯網、穿戴式裝置、無人機、VR/AR、機器人及人工智慧（AI）等相關產業帶動半導體產業成長，加上金門特殊的地理位置，目前廈門聯電投資的 12 吋晶圓廠開始投產，並與本校接洽企業實習，以及提供就業機會，故其能藉由積體電路佈局與封裝測式課程實作，以落實就業市場所迫切需要之高科技專長。

為配合此教育目標及因應半導體產業產學發展，提升金門大學電子系在半導體設計、製造、封裝測試，提升教學品質暨研究能量，改善積體電路設計實驗室教學設備，並藉由積體電路佈局與封裝測式課程實作，發展高科技專長，並積極的參加教育部及業界所舉辦的積體電路設計及佈局的比賽。並將積極爭取執行研究計畫、產學合作案及建教合作案，透過計畫及專案的執行提供學生更完善的研究環境。同時落實教學創新及提升教學品質、業界師資的講座，產業實習，以降低產學的落差。

貳、績效指標

分項計畫或推動策略	質化指標		量化指標							
	項目	檢核方式	項目	衡量基準 (計算公式)	106年 現況值	107年 目標值	108年 目標值	109年 目標值	110年 目標值	111年 目標值
1-4-A：半導體產業產學發展計畫	建構學生學習評估指標並追蹤成效	學生教學評量達4.0	學生學習成效	次數/學期	1	1	1	1	1	1
	企業參訪理論與實務結合	辦理企業參訪，了解產業需求降低產學落差	辦理企業參訪，學生參與之情況	參加人次/年	0	15	20	20	20	20
	實習制度建置情形及參與專業實習之學生人數	學生赴企業實習人數	實習制度建置情形及參與專業實習學生人數之情況	參加人次/年	2	4	4	4	4	4
	規劃學界業界師資的講座，產業實習提供	規劃學界業界師資的講座，產業實習提供就業機會	定期公開辦學資訊在網頁上產業界師資的講座之情況	舉辦場次/年	2	6	7	7	7	7